

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تهیه کننده

محمد نظری قهرودی

عنوان مقاله

المان خنک کننده TEC

1401

## فهرست

|    |  |
|----|--|
| ۵  | چکیده                                  |
| ۶  | مقدمه                                  |
| ۶  | تاریخچه                                |
| ۷  | اثر پلته                               |
| ۸  | ساخت ماژول ترموالکتریک                 |
| ۹  | ماتریس منظم عناصر PELLETS – TE         |
| ۱۰ | لایه های سرامیکی                       |
| ۱۱ | هادی های الکتریکی                      |
| ۱۱ | لحیم کاری                              |
| ۱۲ | عملکرد TEC                             |
| ۱۴ | عملکرد استاندارد                       |
| ۱۴ | فیگور شایستگی                          |
| ۱۴ | قابلیت اطمینان TEC                     |
| ۱۵ | انتخاب ماژول TE برای یک برنامه کاربردی |
| ۱۶ | نصب TEC                                |
| ۱۶ | نصب مکانیکی                            |
| ۱۶ | لحیم کاری                              |
| ۱۷ | چسباندن                                |
| ۱۷ | شناسایی و خصوصیات                      |
| ۱۷ | مزایا                                  |
| ۱۸ | معایب                                  |
| ۱۹ | کاربرد TEC                             |
| ۱۹ | محصولات مصرفی                          |
| ۱۹ | صنعتی                                  |
| ۱۹ | علم و تصویربرداری                      |
| ۲۰ | TEG                                    |

|    |                 |
|----|-----------------|
| ۲۰ | نتیجه گیری..... |
| ۲۱ | منابع.....      |

## فهرست تصاویر

|    |   |
|----|---|
| ۶  | تصویر ۱.....                                  |
| ۷  | تصویر ۲.....                                  |
| ۷  | تصویر ۳.....                                  |
| ۷  | تصویر ۴.....                                  |
| ۸  | تصویر ۵.....                                  |
| ۸  | تصویر ۶- single stage.....                    |
| ۹  | تصویر ۷- multi stage.....                     |
| ۹  | تصویر ۸- مقایسه single & multi.....           |
| ۹  | تصویر ۹.....                                  |
| ۱۰ | تصویر ۱۰- P type.....                         |
| ۱۰ | تصویر ۱۱- N type.....                         |
| ۱۰ | تصویر ۱۲- Electrical conductivity p-type..... |
| ۱۰ | تصویر ۱۳- Electrical conductivity p-type..... |
| ۱۰ | تصویر ۱۴- Electrical conductivity N-type..... |
| ۱۰ | تصویر ۱۵- Electrical conductivity N-type..... |
| ۱۱ | تصویر ۱۶.....                                 |
| ۱۱ | تصویر ۱۷.....                                 |
| ۱۲ | تصویر ۱۸.....                                 |
| ۱۲ | تصویر ۱۹.....                                 |
| ۱۲ | تصویر ۲۰.....                                 |
| ۱۳ | تصویر ۲۱.....                                 |

|    |       |          |
|----|-------|----------|
| ١٣ | ..... | تصویر ٢٢ |
| ١٣ | ..... | تصویر ٢٣ |
| ١٣ | ..... | تصویر ٢٤ |
| ١٣ | ..... | تصویر ٢٥ |
| ١٣ | ..... | تصویر ٢٦ |
| ١٤ | ..... | تصویر ٢٧ |
| ١٥ | ..... | تصویر ٢٨ |
| ١٦ | ..... | تصویر ٢٩ |
| ١٦ | ..... | تصویر ٣٠ |
| ١٧ | ..... | تصویر ٣١ |
| ٢٠ | ..... | تصویر ٣٢ |
| ٢٠ | ..... | تصویر ٣٣ |

## فهرست جداول

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| ٩ | ..... | جدول ١ |
|---|-------|--------|

## چکیده

امروزه، فناوری ترموالکتریک مانند ژنراتورهای ترموالکتریک (TEG) و سیستم های خنک کننده ترموالکتریک (TEC) بسیار گسترش یافته و در زمینه های مختلف صنعتی، علمی پژوهشی، تولید برق و ۰۰۰ استفاده کرد و به دلیل هزینه کم آن و عاری بودن از نویز بسیار کاربردی است.

این مقاله اصول ترموالکتریکی را توصیف می کند و توضیحی در مورد مواد فعلی و آینده ارائه می دهد. علاوه بر این، تعدادی از کاربردهای موضعی و منابع انرژی معرفی شده است. هدف اصلی این مطالعه ارائه یک نمای کلی روشن از فناوری و کاربردهای ترموالکتریک است.

## کلمات کلیدی :

اثر پلته، ترموالکتریک، اثر سیبک، بیسموت تلراید

ترموالکتريک استفاده می شود. در مقابل گرمایش ژول که متناسب با مجذور جريان است:

$$Q = R \times I^2$$

گرماي پلتيه (Qp) به عنوان تابعي خطي از جريان تغيير می کند و علامت خود را با آن تغيير می دهد:

$$Q_p = P \times q$$

که در آن q باري است که از محل اتصال می گذرد (q)  $P = I \times t$ ; ضريب پلتيه است که مقدار آن به ماهيت مواد تماس و دماي تماس بستگي دارد. روش رايج براي ارائه ضريب پلتيه به شرح زير است:

$$P = \alpha \times T$$

در اینجا  $\alpha$  - آلفا ضريب Seebeck است که با مواد تماس، خواص و دماي آنها تعريف می شود. T دماي محل اتصال بر حسب کلوين است(۱).

اگرچه پديده ترموالکتريک (TE) بيش از ۱۵۰ سال پيش کشف شد، دستگاه های ترموالکتريک (کولرهای TE) تنها در دهه های اخير به صورت تجاري مورد استفاده قرار گرفته اند. براي مدتی، TEC های تجاري به موازات دو جهت جريان اصلي پيشرفت فني - الکترونيک و فوتونيک، به ويژه اپتوالکترونيک و تکنیک های ليزر در حال توسعه هستند. اخيراً افزايش چشمگيري در کاربرد راه حل های TE در دستگاه های اپتوالکترونيک مشاهده شده است، مانند ليزرهای ديود، ديودهای سوپرلومينسانس (SLD)، آشکارسازهای نوري مختلف، ليزرهای حالت جامد پمپ شده با ديود (DPSS)، دستگاه های کوپل شده با شارژ (CCD)، کانوني و آرايه های صفحه (FPA) و غيره.

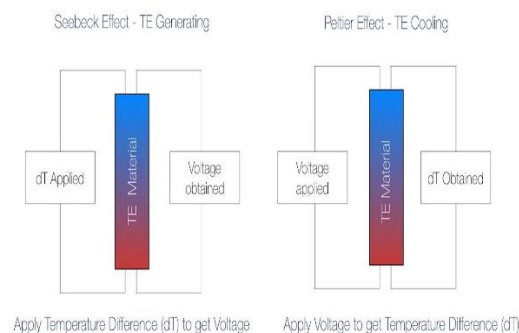
پيشرفت در کاربردها با مزايای خنک کننده های TE فراهم می شود و آنها حالت جامد هستند، هيچ قطعات متحرکی ندارند و مينياتوري، بسيار قابل اعتماد و انعطاف پذير در طراحي هستند تا نيازهای خاص را برآورده کنند.

## تاريخچه

اثر گرمایش يا سرمايش در محل اتصال دو هادی مختلف در معرض جريان به افتخار ساعت ساز فرانسوی ژان پلتيه (۱۷۸۵-۱۸۴۵) که آن را در سال ۱۸۳۴ کشف کرد نامگذاری شد. مشخص شد که اگر جريانی از کنتاکت ها عبور کند. از دو هادی غيرمشابه در یک مدار، یک اختلاف دما بين آنها ظاهر می شود. اين پديده به طور خلاصه اساس ترموالکتريکی است و به طور فعال در به اصطلاح ماژول های خنک کننده



How does it work - Thermoelectric Pellet



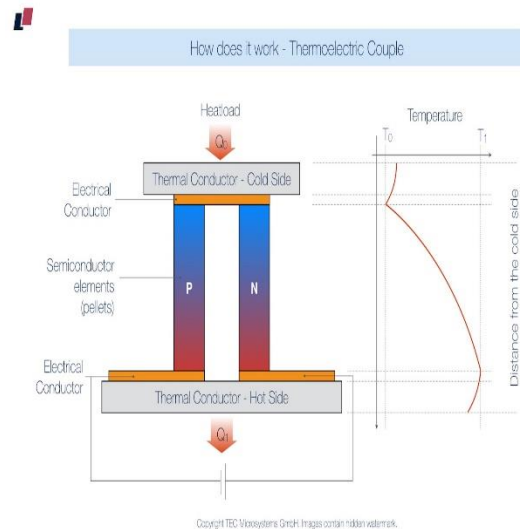
BiTe Material is the most common for TE Coolers manufacturing

Copyright TED Microsystems GmbH. Images contain hidden watermark.

## تصوير ۱

جامد یا خنک کننده ترموالکتریک (TEC) و گاهی اوقات باتری ترموالکتریک هم گفته می شود. می توان از آن برای گرمایش یا سرمایش استفاده کرد، اگرچه در عمل کاربرد اصلی خنک کننده است. ونیز می توان از آن به عنوان یک کنترل کننده دما که گرم یا سرد می شود استفاده کرد(۲).

اثر پلتیه بیان می کند که وقتی جریان الکتریکی از مدار با دو رسانای غیر هم جنس عبور می کند، انرژی گرمایی از یک اتصال گرفته و در اتصال دیگر جذب می شود این امر باعث می شود اولی سردتر و دومی گرم تر شود. به همین دلیل گرادیان حرارتی از جریان عبوری ایجاد می شود که برعکس اثر سی بک است.

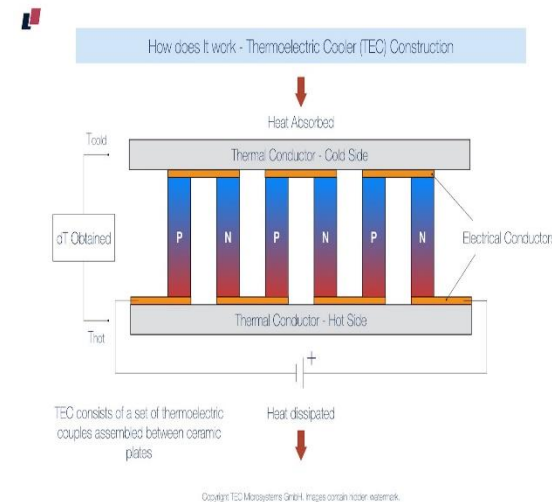


تصویر ۲



تصویر ۴

این فناوری در تبرید بسیار کمتر از تبرید فشرده سازی بخار استفاده می شود. مزیت اصلی کولر پلتیه در مقایسه با یخچال تراکمی بخار عدم وجود قطعات متحرک یا مایع در گردش، عمر بسیار طولانی، آسیب ناپذیری در برابر نشتی، اندازه کوچک و شکل انعطاف پذیر آن است. معایب اصلی آن هزینه بالا برای ظرفیت خنک کننده معین و راندمان ضعیف برق (ضریب عملکرد یا COP پایین) است. بسیاری از محققان و



تصویر ۳

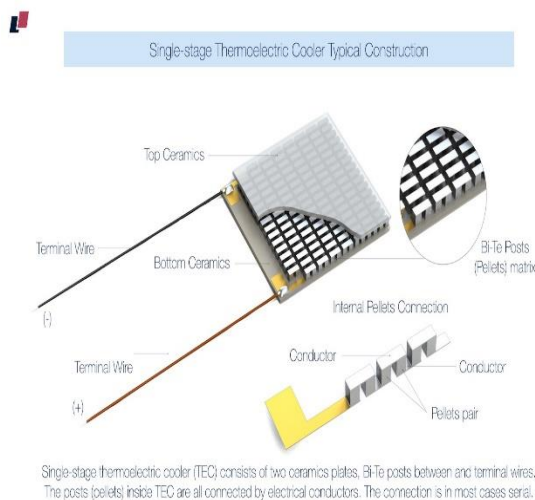
## اثر پلتیه

خنک کننده ترموالکتریک از اثر پلتیه برای ایجاد شار حرارتی در محل اتصال دو نوع مختلف مواد استفاده می کند. کولر، بخاری یا پمپ حرارتی ترموالکتریک پلتیه یک پمپ حرارتی فعال حالت جامد است که با مصرف انرژی الکتریکی بسته به جهت جریان، گرما را از یک طرف دستگاه به طرف دیگر منتقل می کند. به چنین ابزاری، دستگاه پلتیه، پمپ حرارتی پلتیه، یخچال حالت

متعدد را می توان برای دمای پایین تر به صورت آبشاری یا کنار هم قرار داد، اما راندمان کلی (COP) به طور قابل توجهی کاهش می یابد. حداکثر COP هر چرخه تبرید در نهایت با تفاوت بین دمای مطلوب (سمت سرد) و دمای محیط (سمت گرم) (دمای هیت سینک) محدود می شود. هر چه اختلاف دما (دلتا) بیشتر باشد، حداکثر COP نظری کمتر است.

### ساخت ماژول ترموالکتریک

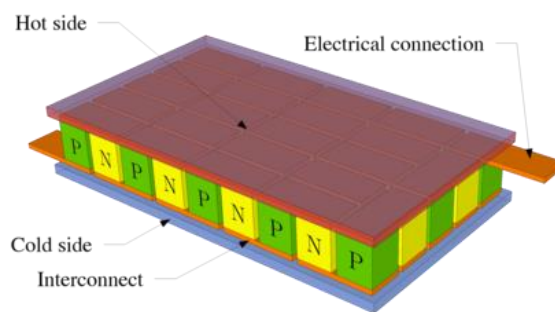
یک ماژول TE دستگاهی متشکل از زوج های ترموالکتریک (گلوله های نیمه هادی نوع N و P) است که به صورت الکتریکی به صورت سری، موازی حرارتی به هم وصل شده و با لحیم کاری ثابت شده و بین دو صفحه سرامیکی قرار گرفته اند. دومی دو طرف خنک کننده ترموالکتریک گرم و سرد (TEC) را تشکیل می دهد. پیکربندی کولرهای ترموالکتریک کلاسیک در زیر نشان داده شده است:



تصویر ۶- single stage

شرکت ها در تلاش هستند تا کولرهای پلتیه را تولید کنند که ارزان و کارآمد باشد.

کولر Peltier همچنین می تواند به عنوان یک ژنراتور ترموالکتریک استفاده شود. هنگامی که به عنوان یک خنک کننده کار می کند، ولتاژی به دستگاه اعمال می شود و در نتیجه اختلاف دما بین دو طرف ایجاد می شود. هنگامی که به عنوان یک ژنراتور کار می کند، یک طرف دستگاه تا دمای بالاتر از طرف دیگر گرم می شود و در نتیجه، اختلاف ولتاژ بین دو طرف ایجاد می شود (اثر Seebeck). با این حال، یک خنک کننده Peltier با طراحی خوب، به دلیل طراحی و بسته بندی متفاوت، یک ژنراتور ترموالکتریک متوسط خواهد بود و بالعکس.

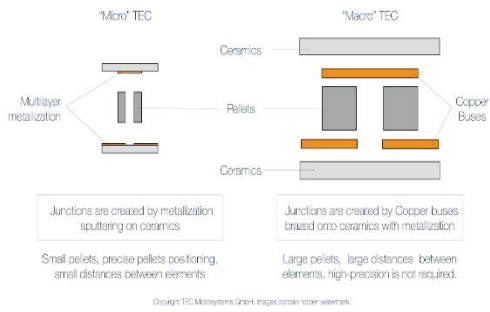


تصویر ۵

خنک کننده های ترموالکتریک با اثر پلتیه (یکی از سه پدیده ای که اثر ترموالکتریک را تشکیل می دهند) کار می کنند. این دستگاه دارای دو طرف است و هنگامی که جریان الکتریکی DC از دستگاه عبور می کند، گرما را از یک طرف به طرف دیگر می آورد، به طوری که یک طرف سردتر و طرف دیگر گرمتر می شود. سمت "گرم" به یک هیت سینک وصل می شود تا در دمای محیط باقی بماند، در حالی که سمت سرد به زیر دمای اتاق می رود. در کاربردهای خاص، خنک کننده های



BULK Technology - "Micro" and "Macro" TE Coolers, General Technology Differences



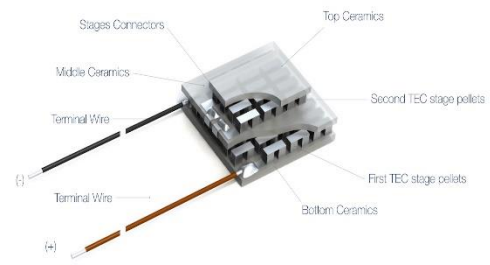
تصویر ۹

مواد عنصر کلیدی ماژول های ترموالکتریک مدرن است. بیسموت تلوراید (BiTe) و آلیاژهای آن به طور گسترده به عنوان مواد خنک کننده ترموالکتریک (TEC) استفاده می شود. آنها همچنین برای استفاده در ژنراتورهای ترموالکتریک (TEG) زمانی که دمای منبع گرما متوسط است، بهینه هستند. در میان روش های مختلف ساخت مواد BiTe، فرآیند اکستروژن گرم، مدرن ترین تکنولوژی است. مواد BiTe اکستروژن شده گرم بهترین تعادل عملکرد و خواص مکانیکی را دارند که برای تولید کولرهای ترموالکتریک و ژنراتورها مناسب است (۳). علی رغم تلاش های مختلف برای یافتن جایگزین ها، بیسموت تلوراید هنوز هم شناخته شده ترین ماده ترموالکتریک مورد استفاده تجاری به صورت فله برای خنک سازی و تولید برق است (۴).

| Material Properties | $\alpha$<br>uV/K | $\sigma$<br>1/Ohm x cm | $\alpha^2\sigma$<br>uW/cm x K <sup>2</sup> | Zx1000<br>1/K |
|---------------------|------------------|------------------------|--|---------------|
| P- Type             | $\geq 195$       | 950 - 1100             | $\geq 40$                                  | $\geq 3.05$   |
| N- Type             | $\geq 195$       | 950 - 1100             | $\geq 38$                                  | $\geq 2.75$   |

جدول ۱

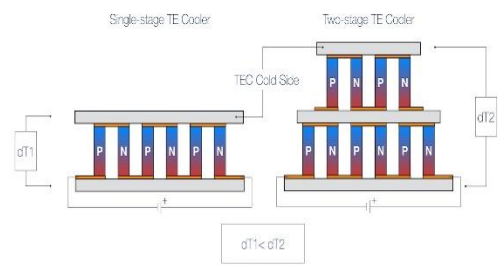
Multistage Thermolectric Coolers - Two-stage TEC Example



In multi-stage TECs every previous stage cools down the next one. Thus the resulting  $\Delta T$  between hot and cold sides is higher comparing to a single-stage TEC. TECs with 2, 3 or 4-stage solutions are common, in some rare cases - 5 or 6

تصویر ۷ - multi stage

How does it work - Single- and Multistage TE Coolers



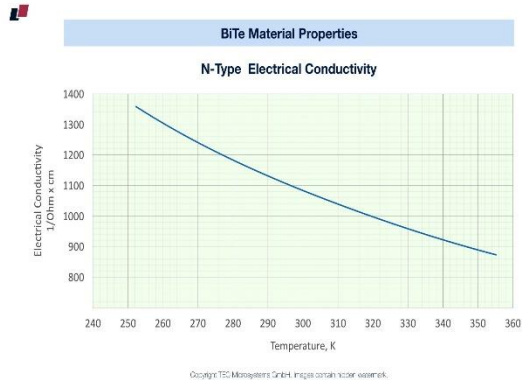
Multistage TE Coolers allow obtaining higher temperature difference between Cold and Hot sides

تصویر ۸ - مقایسه single & multi

معمولاً یک ماژول ترموالکتریک از بخش های زیر تشکیل شده است:

ماتریس منظم عناصر TE - PELLETS

معمولاً از نیمه هادی هایی مانند بیسموت تلوراید (BiTe)، تلورید آنتیموان یا محلول های جامد آنها استفاده می شود. نیمه هادی ها به دلیل عملکرد بهینه TE پیچیده و ویژگی های تکنولوژیکی در بین مواد شناخته شده بهترین هستند. مواد BiTe معمولی ترین برای خنک کننده TE است.



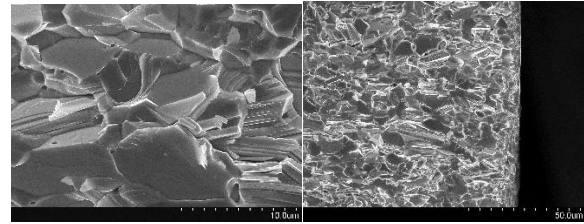
تصویر ۱۴- Electrical conductivity N-type



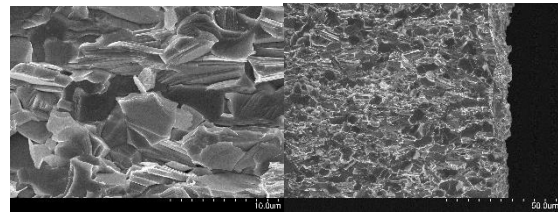
تصویر ۱۵- Electrical conductivity N-type

### لایه های سرامیکی

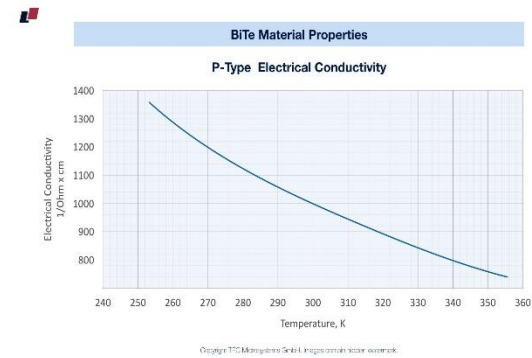
لایه های سرامیکی سرد و گرم (و متوسط برای کولرهای چند مرحله ای) یک ماژول صفحات یکپارچگی مکانیکی یک ماژول TE را فراهم می کنند. آنها باید الزامات سختگیرانه عایق الکتریکی جسمی که قرار است خنک شود و سینک حرارتی را برآورده کنند. صفحات باید رسانایی حرارتی خوبی داشته باشند تا انتقال حرارت با حداقل مقاومت را فراهم کنند. سرامیک های اکسید آلومینیوم ( $Al_2O_3$ ) به دلیل نسبت بهینه هزینه/عملکرد و تکنیک پردازش توسعه یافته بیشترین استفاده را دارند. انواع سرامیک های دیگر مانند نیتريد آلومینیوم ( $AlN$ ) و اکسید بریلیم ( $BeO$ ) نیز استفاده می شود. آنها هدایت



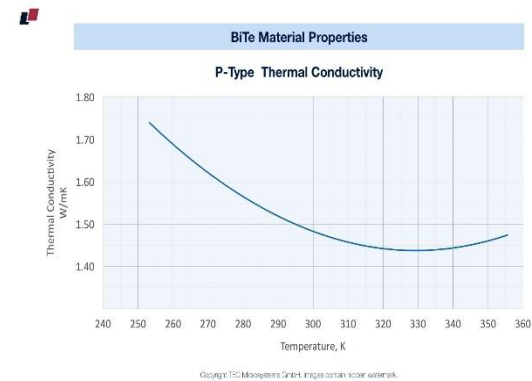
تصویر ۱۰- P type



تصویر ۱۱- N type



تصویر ۱۲- Electrical conductivity p-type



تصویر ۱۳- Electrical conductivity p-type

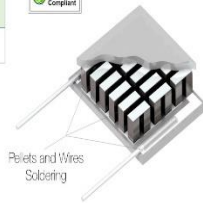


### TEC Microsystems Thermoelectric Coolers Assembly Solders

| TEC Microsystems Standard TEC Internal Assembly Solder |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| Antimony-Tin   | Sn-Sb (85%-15%) | 230°C |



| Optional TEC Internal Assembly Solders |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| Gold-Tin                               | Au-Sn (80%-20%) | 280°C |
| Lead-Tin                               | Pb-Sn (37%-63%) | 183°C |
| Bismuth-Tin                            | Bi-Sn (57%-43%) | 138°C |



TEC Microsystems uses Solder 230 by default for TEC Assembly. Other solutions are available by request.

Copyright TEC Microsystems GmbH. Images contain hidden watermark.

تصویر ۱۷

### لحیم کاری

مونتاژ ماژول TE را فراهم می کند. استانداردترین لحیم های مورد استفاده شامل آلیاژهای سرب-قلع (Pb-Sn)، آنتیموان-قلع (Sn-Sb) و طلا-قلع (Au-Sn) می باشد. لحیم کاری ها باید مونتاژ خوبی از ماژول TE را فراهم کنند. نقطه ذوب یک لحیم کاری یکی از عوامل محدود کننده برای فرآیندهای جریان مجدد کولر TE و دمای عملیاتی است. سیم های پیشرو به هادی های انتهایی متصل می شوند و برق را از منبع الکتریکی جریان مستقیم (DC) تامین می کنند.

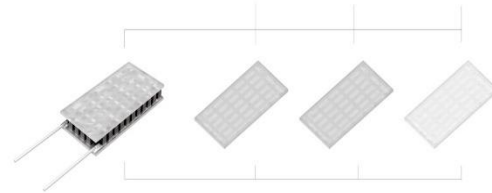
یک ماژول تک مرحله ای از یک ماتریس گلوله و یک جفت طرف سرد و گرم تشکیل شده است. یک ماژول چند مرحله ای را می توان به صورت دو یا چند مرحله تکی که روی هم چیده شده اند مشاهده کرد. ساخت یک ماژول چند مرحله ای معمولاً از نوع هرمی است - هر مرحله پایین تر از مرحله بالایی بزرگتر است. هنگامی که از مرحله بالا برای خنک کردن استفاده می شود، مرحله پایین به ظرفیت خنک کننده بیشتری برای پمپاژ حرارتی که از مرحله بالایی دفع می شود نیاز دارد.

حرارتی بسیار بهتری دارند - پنج تا هفت برابر بیشتر از Al2O3 - اما هر دو گرانتز هستند. علاوه بر این، فناوری BeO سمی است.



### Thermoelectric Cooler Ceramics Materials

| Property               | Units               | AlN 100%          | Al2O3 100%        | Al2O3 96%         |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Thermal Conductivity   | W/(m x K)           | >170              | 30                | 24                |
| Thermal Expansion      | 10 <sup>-6</sup> /K | 4.6               | 7.2               | 7                 |
| Electrical Resistivity | Ohm x cm            | >10 <sup>14</sup> | >10 <sup>14</sup> | >10 <sup>14</sup> |



TEC Microsystems uses 100% AlN and AlN Ceramics for thermoelectric cooler manufacturing

Copyright TEC Microsystems GmbH. Images contain hidden watermark.

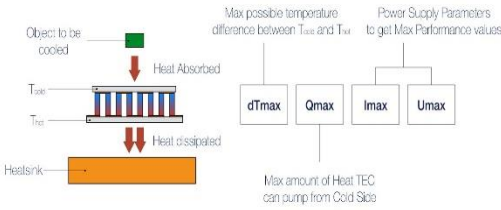
تصویر ۱۶

### هادی های الکتریکی

برقراری تماس الکتریکی سریال گلوله ها با یکدیگر و تماس با سیم های پیشرو. برای بیشتر خنک کننده های TE مینیاتوری، هادی ها به صورت لایه های نازک (ساختار چند لایه حاوی مس (مس) به عنوان هادی) ساخته می شوند که روی صفحات سرامیکی قرار می گیرند. برای کولرهای با اندازه بزرگ و پر قدرت، آنها از زبانه های Cu ساخته شده اند تا مقاومت را کاهش دهند.



### How does it work - TE Cooler Key Parameters



TE Cooler operates as a Heatpump. It transfers the Heat from Cold side to Hot Side and provides  $dT$  if required

Copyright: TEC Microsystems GmbH. Images contain watermarks.

### تصویر ۱۹

معمولاً سازندگان پارامترهای عملکرد کولر TE را در دمای محیط  $30.0^{\circ}\text{C}$  ( $27^{\circ}\text{C}$ ) در خلاء یا  $\text{O}_2$  در  $323\text{ K}$  ( $50^{\circ}\text{C}$ ) در شرایط نیتروژن خشک ( $\text{N}_2$ ) مشخص می کنند.



### TEC Microsystems TECs are assembled with RoHS compliant Solder 230 by default



Solder 230 requires very high technology level in volume manufacturing, especially for multistage TEC Coolers. Other vendors multistage TECs are assembled commonly with Solder 183 or Solder 138

Copyright: TEC Microsystems GmbH. Images contain watermarks.

### تصویر ۱۸

## عملکرد TEC

کولرهای ترموالکتریک را می توان با پارامترهای عملکرد حداکثر با دمای اتصال داغ ( $T_1$ ) مشخص کرد (۵). معمولاً آنها در مشخصات استاندارد یک ماژول ذکر شده اند:

$\Delta T_{max}$  – حداکثر اختلاف دما در امتداد ماژول در بار حرارتی صفر  $Q=0$

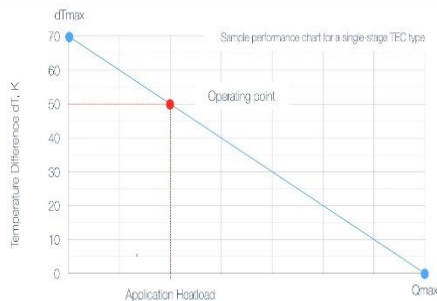
$Q_{max}$  – حداکثر ظرفیت خنک کننده متناظر با  $T_{max}=0\Delta$

$I_{max}$  – جریان دستگاه در  $T_{max}\Delta$

$U_{max}$  – ولتاژ ترمینال برای  $I_{max}$  بدون بار حرارتی



### Understanding TE Cooler General Parameters, $dT_{max}$ and $Q_{max}$



$dT_{max}$  for TEC is specified without Heatload.  $Q_{max}$  is specified at  $dT=0$ . The application point is in between.

Copyright: TEC Microsystems GmbH. Images contain watermarks.

### تصویر ۲۰

همه پارامترهای عملکرد در یک رابطه متقابل با یکدیگر هستند. تجزیه و تحلیل صحیح یک عملیات TEC در برنامه واقعی را می توان با استفاده از نمودارهای عملکرد، که نتایج وابستگی متقابل بین آنها است، انجام داد. توجه به این نکته مهم است که پارامترهای عملکرد کولر TE به شرایط محیطی بستگی دارد.



### TEC $dT_{max}$ parameter is affected by Ambience



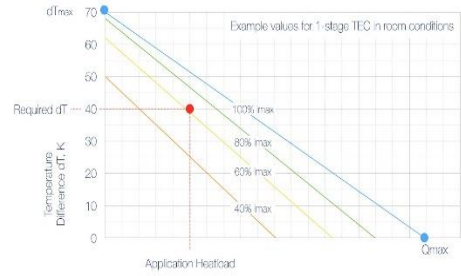
Multistage TE Coolers are more sensitive to convective heatload from gas-filled Ambience. For multistage TE Coolers best performance it's recommended to use Vacuum or inert gases Ambience.

Copyright TEC Microsystems GmbH. Images contain trade watermark.

### تصویر ۲۴



### TEC is DC Current regulated Device



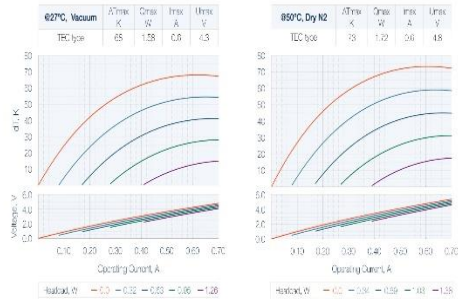
TEC Cold Side Temperature and Cooling Capacity in Application are regulated by applied electrical DC Current.

Copyright TEC Microsystems GmbH. Images contain trade watermark.

### تصویر ۲۱



### TEC Microsystems TE Cooler Performance Plots Example



TEC Microsystems Datasheets show standard TEC Performance in typical ambient condition modes. TEC Performance plots can be recalculated for special ambient conditions by request.

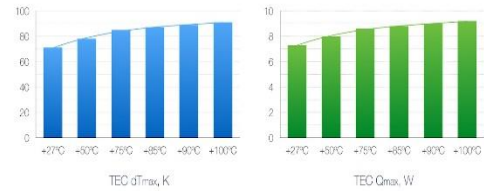
Copyright TEC Microsystems GmbH. Images contain trade watermark.

### تصویر ۲۵



### TEC $dT_{max}$ and $Q_{max}$ parameters are connected to Ambient Temperature

TEC  $dT_{max}$  and  $Q_{max}$  grow with Ambient Temperature. Example data for a single-stage TEC.



$Q_{max}$  and  $dT_{max}$  values depends on ambient temperature. It's important to keep in mind. Typical TEC datasheet has  $dT_{max}$  and  $Q_{max}$  values usually specified at +27°C ambient and/or +50°C.

Copyright TEC Microsystems GmbH. Images contain trade watermark.

### تصویر ۲۲



### Typical Level of TEC $dT_{max}$ parameter Reduction in Gas Filled Ambience

| Gas Type | Thermal Conductivity W/mK | Mean Level of $dT_{max}$ Reduction (compared to $dT_{max}$ in Vacuum), K |         |         |         |
|----------|---------------------------|--|---------|---------|---------|
|          |                           | 1-stage  | 2-stage | 3-stage | 4-stage |
| Dry Air  | 0.026                     | -4   | -9      | -12     | -18     |
| Dry N2   | 0.024                     | -4   | -9      | -12     | -18     |
| Argon    | 0.018                     | -3   | -6      | -9      | -14     |
| Xenon    | 0.006                     | -2   | -4      | -5      | -10     |

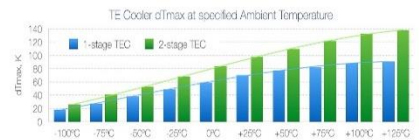
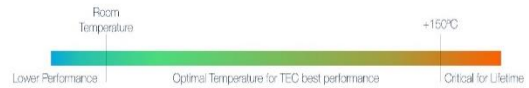
Additional Passive Heatload by Gas Convection affect TEC performance. The affect is usually not so critical for single-stage TE Coolers, but may be significant for multistage TECs.

Copyright TEC Microsystems GmbH. Images contain trade watermark.

### تصویر ۲۶



### Ambient Temperature and TEC Performance



B/Tc material in TE Cooler has the best performance at near room temperature and higher. Lower temperatures reduce TE Performance. High temperatures (after +150°C) affect TEC Lifetime crucially.

TEC doesn't work at CRYO-temperatures. Copyright TEC Microsystems GmbH. Images contain trade watermark.

### تصویر ۲۳

## عملکرد استاندارد

یک مشخصات معمولی برای خنک کننده ترموالکتریک شامل نمودارهای عملکردی است که نشان دهنده رابطه متقابل بین  $I_{max}$ ،  $U_{max}$ ،  $Q_{max}$  و  $\Delta T_{max}$  است. نمونه های معمولی در مثال بالا نشان داده شده است. معمولاً پارامترهای عملکرد TEC و نمودارهای عملکرد استاندارد توسط سازندگان در  $300K$ ، شرایط محیطی خلاء و در  $223K$ ،  $N_2$  خشک مشخص می شوند.

## فیگور شایستگی (Z)

پارامترهای عملکردی بیشتری وجود دارد که معمولاً در مشخصات استاندارد کولرهای TE تجاری ارائه نمی شوند، اما نقش بسیار مهمی در مشخصه مازول ترموالکتریک دارند (۲).

این پارامترها خواص مواد گلوله (رسانایی حرارتی (k)، مقاومت الکتریکی (R) و ضریب Seebeck) به صورت زیر هستند:

$$Z = \frac{a^2}{KR}$$

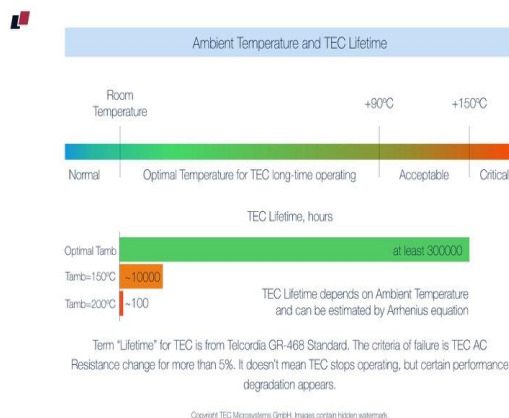
پارامتر Z معمولاً به عنوان "شخصیت شایستگی" نامیده می شود. مقدار معمولی Z در محدوده  $10^{-3} \times 2/5 - 3/2$  مقدار شناخته شده Z امکان تخمین  $\Delta T_{max}$  یک TEC تک مرحله ای را با فرمول ساده می دهد:

$$AT_{max} = \frac{1}{2} ZT_0^2$$

که در آن  $T_0$  دمای طرفی است که کار انجام شده است.

## قابلیت اطمینان TEC

کولرهای تجاری TE طول عمر طولانی را در محدوده  $250,000$  تا  $350,000$  ساعت در شرایط عادی فراهم می کنند. این نتیجه یک فناوری بسیار پیشرفته تولید و مواد اولیه با کیفیت بالا است. در بسیاری از کاربردها، TEC یک جزء حیاتی است زیرا بر دمای کل دستگاه تأثیر می گذارد و می تواند بر عملکرد صحیح آن و همچنین تأثیر بر ائتلاف گرما تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که روش های تست قابلیت اطمینان شدید مورد نیاز است (۶).



تصویر ۲۷

برای این منظور، استانداردهای تست ملی و بین المللی زیادی وجود دارد. آنها برای طیف وسیعی از صلاحیت های دستگاه های الکترونیکی و نوری یکپارچه هستند. در بازار بین المللی، استانداردهای Bellcore رایج ترین هستند، یعنی GR-468 (تضمین قابلیت اطمینان برای دستگاه های الکترونیکی نوری).

حداقل مجموعه استاندارد روش های تست شامل تست شوک مکانیکی، تست ارتعاش، تست نیروی برشی،

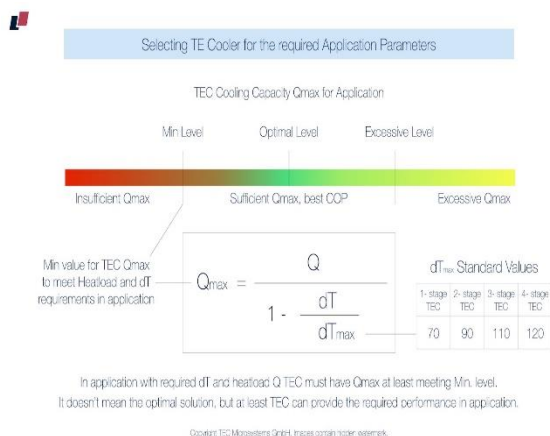
$\Delta T$  - اختلاف دمای عملیاتی (در دمای شناخته شده  $T_{a/hot}$  Thumthaint Thinth).

$Q$  - ظرفیت خنک کننده عملیاتی؛

$I$  - جریان اعمال شده یا موجود؛

$U$  - ولتاژ ترمینال؛ و محدودیت های ابعادی و دیگران.

یک کاربر می تواند تخمین تقریبی اما سریع ظرفیت خنک کننده را به صورت زیر انجام دهد:



### تصویر ۲۸

در بین هر گروه (انواع تک مرحله ای و چند مرحله ای)، ماژول هایی با ظرفیت خنک کننده متفاوت  $Q$  وجود دارد. ظرفیت خنک کننده کولر ترموالکتریک به تعداد گلوله ها و هندسه آنها بستگی دارد. گلوله های با ارتفاع کم یا/و سطح مقطع گلوله های بزرگتر، ظرفیت خنک کننده بالاتری را برای کولر ترموالکتریک فراهم می کند. در همان زمان آنها جریان عملیاتی و مصرف برق کل را افزایش می دهند. سطح مقطع گلوله های کوچک و گلوله های بلند حداکثر اختلاف دما را افزایش می دهند و مصرف برق TEC را کاهش می دهند، اما ظرفیت خنک کننده نیز کاهش می یابد (۷).

تست ذخیره سازی در دمای بالا، تست استقامت چرخه دما می باشد.

معیارهای شکست. معیارهای شکست پیشنهادی که در عمل برای تست های قابلیت اطمینان وجود دارد به شرح زیر است:

- افت حداکثر ظرفیت خنک کننده  $\Delta T_{max}$  TEC به زیر درجه بندی مشخص شده آن

- و افزایش مقاومت 5% TEC یا بالاتر.

کنترل هر دو معیار در روش Z-metering که سریع و کاملاً دقیق توسط دستگاه تست Z-Meter تحقق یافته است، قابل دستیابی است. دومی اندازه گیری رقم برتری Z و بنابراین اندازه گیری  $\Delta T_{max}$  و مقاومت جریان متناوب (AC R) را فراهم می کند.

پارامترهای Z و ACR به کیفیت TEC و هر گونه خرابی بسیار حساس هستند. هر گونه تغییر جزئی در یک ماژول - تخریب گلوله ها، اتصالات، سرامیک و غیره - بلافاصله منجر به تغییر قابل توجه Z (کاهش) و ACR (افزایش) در برابر مقادیر ثابت اولیه می شود.

### انتخاب ماژول TE برای یک برنامه کاربردی

هر برنامه خاصی که در آن ماژول TE مورد نیاز است با مجموعه ای از پارامترها و محدودیت های عملیاتی مشخص می شود که ضرورت انتخاب دقیق نوع TEC بهینه را در میان طیف گسترده ای از TEC های تک مرحله ای و چند مرحله ای دیکته می کند. این پارامترها عبارتند از:

## نصب TEC

در عمل، عملکرد و طول عمر عملیاتی کولر ترموالکتریک به طور قابل توجهی به عوامل زیادی بستگی دارد و روش صحیح نصب بسیار مهم است. نصب اولین روش قبل از استفاده از کولر TE است. روش نصب و مواد اعمال شده باید تماس های حرارتی خوب و حداقل مقاومت حرارتی را فراهم کند (۸).

## نصب مکانیکی

ماژول TE بین دو مبدل حرارتی قرار می گیرد. این ساندویچ توسط پیچ یا به روش مکانیکی دیگر ثابت می شود. مزیت تثبیت توسط پیچ در امکان جداسازی سریع و آسان در صورت نیاز است. برای خنک کننده های بزرگ، به عنوان مثال، با سطوح خارجی ۳۰ x ۳۰ mm<sup>2</sup> یا بیشتر مناسب است. انواع مینیاتوری به روش های مختلف مونتاژ نیاز دارند.

## لحیم کاری

این یک روش جهانی برای اکثر کولرهای TE مینیاتوری است. این روش شامل آماده سازی ماژول TE با سطوح بیرونی پوشیده از فلز (طرف سرد و گرم) است. در طول لحیم کاری، یک خنک کننده TE برای مدت کوتاهی گرم می شود، اما تا دمای بالا. از این رو:

- نقطه ذوب لحیم کاری خارجی باید همیشه کمتر از لحیم کاری داخلی ماژول باشد.

- مدت زمان لحیم کاری باید تا حد امکان کوتاه باشد تا زمان گرم شدن بیش از حد کاهش یابد.



The Balance of Powers - Optimal C.O.P.



1. The most powerful TEC doesn't mean the most optimal one. A lot depends on application.
2. For an application with specified Heatload and  $dT$  there is always an optimal solution by C.O.P.
3. Every TEC type has an optimal heatload range (with the highest C.O.P.) at required  $dT$  specified.

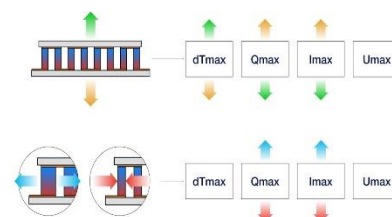
Copyright: TEC Microsystems GmbH. Images contain watermarks.

## تصویر ۲۹

اگر محدودیت های معمول در منبع تغذیه را نیز در نظر بگیرید، انتخاب صحیح می تواند به یک کار پیچیده تبدیل شود. به منظور تسریع و بهینه سازی این رویه، اکثر تامین کنندگان نوعی کمک را توصیه می کنند. علاوه بر این، برخی از آنها به کاربران در مورد نرم افزاری توصیه می کنند که به آنها اجازه می دهد در میان TEC ها جستجو کنند و در مورد انتخاب بهینه با استفاده از تجزیه و تحلیل پایگاه داده رایانه ای انواع ماژول TE موجود با مدل سازی دقیق رفتار ماژول TE بتن در شرایط عملیاتی خاص تصمیم گیری کنند.



TE Cooler Performance Parameters and Pellets Geometry



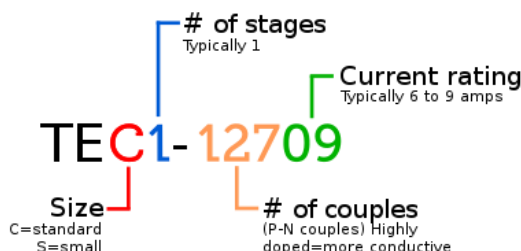
Lower pellets make TEC cooling capacity higher, but increase the parameter  $Imax$ . The same effect has pellets cross-section increasing (w/o height change).

Copyright: TEC Microsystems GmbH. Images contain watermarks.

## تصویر ۳۰



آمپر به فروش می‌رسد. مقاومت الکتریکی آنها قدر ۱-۲ اهم خواهد بود.



تصویر ۳۱

## مزایا

یکی از مزایای قابل توجه سیستم های TEC این است که آنها قطعات متحرک ندارند. این عدم سایش مکانیکی و کاهش موارد خرابی ناشی از خستگی و شکستگی ناشی از لرزش و تنش مکانیکی باعث افزایش طول عمر سیستم و کاهش نیازهای تعمیر و نگهداری می شود. فن آوری های کنونی نشان می دهند که میانگین زمان بین خرابی ها (MTBF) بیش از ۱۰۰۰۰۰ ساعت در دمای محیط است.

این واقعیت که سیستم های TEC با جریان کنترل می شوند منجر به یک سری مزایای دیگر می شود. از آنجایی که جریان گرما به طور مستقیم با جریان DC اعمال شده متناسب است، گرما ممکن است با کنترل دقیق جهت و مقدار جریان الکتریکی اضافه یا حذف شود. برخلاف روش هایی که از روش های گرمایش یا سرمایش مقاومتی استفاده می کنند که شامل گازها می شود، TEC امکان کنترل یکسانی بر جریان گرما (هم در داخل و هم خارج از یک سیستم تحت کنترل) را فراهم می کند. به دلیل این کنترل دقیق جریان گرما دو طرفه، دمای سیستم های کنترل شده می تواند تا

معمولاً به دلیل تنش حرارتی، استفاده از لحیم کاری برای TEC هایی با ابعاد خطی اضلاع بیش از ۱۸ میلی متر توصیه نمی شود. در این مورد، انتخاب مواد بسیار دقیق مورد نیاز است.

## چسباندن

به دلیل سادگی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً از ترکیبات اپوکسی پر شده با مواد رسانای حرارتی مانند پودر گرافیت، نقره، نیتريد سیلیکون (SiN) و غیره استفاده می شود.

با این حال، محدودیت های کلی به شرح زیر وجود دارد.

- برخی از اپوکسی ها دمای عملیاتی پایینی دارند که آنها را برای خنک کننده های TE با دمای بالا نامناسب می کند.
- روش مناسبی برای کاربردهای با خلاء بالا نیست زیرا اپوکسی مشکلاتی را در خروج گاز ایجاد می کند.

## شناسایی و خصوصیات

اکثریت قریب به اتفاق کولرهای ترموالکتریک دارای شناسه ای هستند که در قسمت خنک شده چاپ شده است. این شناسه های جهانی به وضوح اندازه، تعداد مراحل، تعداد زوج ها و رتبه بندی جریان بر حسب آمپر را نشان می دهند، همانطور که در نمودار مجاور دیده می شود.

**Tec1-12706** بسیار رایج، مربعی با اندازه ۴۰ میلی متر و ارتفاع ۳ تا ۴ میلی متر، با چند دلار یافت می شود و به عنوان توانایی حرکت در حدود ۶۰ وات یا ایجاد اختلاف دمای ۶۰ درجه سانتی گراد با جریان ۶

ندارند به همین دلیل کم‌حجم هستند و وزن پایینی دارند.

## معایب

سیستم‌های TEC دارای تعدادی معایب قابل توجه هستند. مهمتر از همه، بازده انرژی محدود آنها در مقایسه با سیستم‌های معمولی فشرده‌سازی بخار و محدودیت‌های کل شار حرارتی (جریان گرما) است که آنها قادر به تولید در واحد سطح هستند. این موضوع در بخش عملکرد زیر بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. و به طور کلی:

- مصرف انرژی بالا و راندمان پایین این
- المان‌های سرد کننده توانایی محدودی در تبدیل گرما دارند و در مکان‌هایی با گرمای بالا ممکن است نتوانند به نتیجه مطلوب برسند.
- فناوری ساخت المان‌های خنک کننده نوپا است (۹).

کولرهای ترموالکتریک برای کاربردهایی استفاده می‌شود که نیاز به حذف حرارت از میلی وات تا چند هزار وات دارند. آنها را می‌توان برای کاربردهایی به کوچکی یک خنک کننده نوشیدنی یا به بزرگی یک زیردریایی یا واگن راه آهن ساخت. عناصر TEC طول عمر محدودی دارند. قدرت سلامتی آنها را می‌توان با تغییر مقاومت (ACR) اندازه گیری کرد. با فرسودگی عنصر خنک‌تر، ACR افزایش می‌یابد (۱۰).

کسری از درجه دقیق باشد، که اغلب در تنظیمات آزمایشگاهی به دقت میلی کلونین (mk) می‌رسد. دستگاه‌های TEC نسبت به هم‌تایان سنتی‌تر خود از نظر شکل انعطاف‌پذیرتر هستند. آنها را می‌توان در محیط‌هایی با فضای کمتر یا شرایط سخت‌تر نسبت به یخچال‌های معمولی استفاده کرد. توانایی تنظیم هندسه آنها امکان ارائه خنک کننده دقیق به مناطق بسیار کوچک را فراهم می‌کند. این عوامل آنها را به یک انتخاب متداول در کاربردهای علمی و مهندسی با الزامات سخت تبدیل می‌کند که در آن هزینه و بهره‌وری مطلق انرژی دغدغه اصلی نیستند (۷).

یکی دیگر از مزایای TEC عدم استفاده از میرد در عملکرد آن است. قبل از حذف تدریجی، برخی از میردهای اولیه، مانند کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs)، به طور قابل توجهی در تخریب لایه ازن نقش داشتند. بسیاری از میردهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند تأثیرات زیست‌محیطی قابل توجهی با پتانسیل گرمایش جهانی دارند یا خطرات ایمنی دیگری را با خود به همراه دارند.

و به طور کلی:

- نشتی گاز ندارند
- نگهداری ارزان
- عمر طولانی
- قابل کنترل
- سازگار با شرایط محیطی مختلف
- رسیدن به دماهای خیلی پایین‌تر از دمای محیط
- دستگاه‌هایی که با ماژول‌های TEC سرما تولید می‌کنند نسبت به یخچال‌ها نیاز به کمپرسور

## کاربرد TEC

### محصولات مصرفی

عناصر Peltier معمولاً در محصولات مصرفی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، آنها در کمپینگ، خنک‌کننده‌های قابل حمل، قطعات الکترونیکی خنک‌کننده و ابزارهای کوچک استفاده می‌شوند. همچنین می‌توان از آنها برای استخراج آب از هوا در دستگاه‌های رطوبت‌گیر استفاده کرد. یک کولر برقی از نوع کمپینگ/خودرو معمولاً می‌تواند دما را تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد (۳۶ درجه فارنهایت) کمتر از دمای محیط کاهش دهد، که اگر دمای خودرو در زیر نور خورشید به ۴۵ درجه سانتی‌گراد برسد، ۲۵ درجه سانتی‌گراد است. ژاکت‌های تحت کنترل آب و هوا شروع به استفاده از عناصر Peltier کرده‌اند. خنک‌کننده‌های ترموالکتریک برای تقویت سینک‌های حرارتی برای ریزپردازنده‌ها استفاده می‌شود.

### صنعتی

خنک‌کننده‌های ترموالکتریک در بسیاری از زمینه‌های تولید صنعتی استفاده می‌شوند و نیاز به تجزیه و تحلیل عملکرد کامل دارند، زیرا قبل از عرضه این محصولات صنعتی به بازار، با آزمایش هزاران چرخه مواجه هستند. برخی از کاربردها عبارتند از تجهیزات لیزر، تهویه مطبوع یا خنک‌کننده ترموالکتریک، الکترونیک صنعتی و مخابرات، خودرو، یخچال‌های کوچک یا انکوباتورها، کابینت‌های نظامی، محفظه‌های IT و موارد دیگر (۱۱).

### علم و تصویربرداری

عناصر Peltier در دستگاه‌های علمی استفاده می‌شود. آنها یک جزء رایج در چرخه‌های حرارتی هستند که برای سنتز DNA توسط واکنش زنجیره

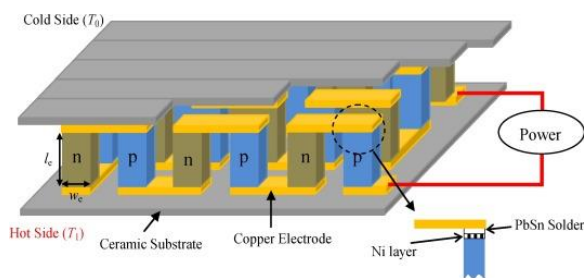
ای پلیمرز (PCR)، یک تکنیک بیولوژیکی مولکولی رایج، استفاده می‌شود که به گرم کردن و خنک شدن سریع مخلوط واکنش برای بازپخت پرایمر دناتوراسیون و چرخه‌های سنتز آنزیمی نیاز دارد. با مدار بازخورد، عناصر Peltier را می‌توان برای پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های دمای بسیار پایدار که دمای مورد نظر را در محدوده  $\pm 0.01$  درجه سانتی‌گراد نگه می‌دارد، استفاده کرد. چنین پایداری ممکن است در کاربردهای لیزری دقیق مورد استفاده قرار گیرد تا از تغییر طول موج لیزر با تغییر دمای محیط جلوگیری شود.

این اثر در ماهواره‌ها و فضاپیماها برای کاهش اختلاف دمای ناشی از نور مستقیم خورشید در یک طرف سفینه با اتلاف گرما در سمت سرد سایه‌دار استفاده می‌شود، جایی که به عنوان تشعشعات حرارتی به فضا پراکنده می‌شود. از سال ۱۹۶۱، برخی از فضاپیماهای بدون سرنشین (از جمله مریخ‌نورد کنجکاوی) از ژنراتورهای ترموالکتریک ایزوتوپ رادیویی (RTGs) استفاده می‌کنند که انرژی حرارتی را با استفاده از اثر Seebeck به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه‌ها می‌توانند چندین دهه دوام بیاورند، زیرا سوخت آن‌ها از تجزیه مواد رادیواکتیو پر انرژی است.

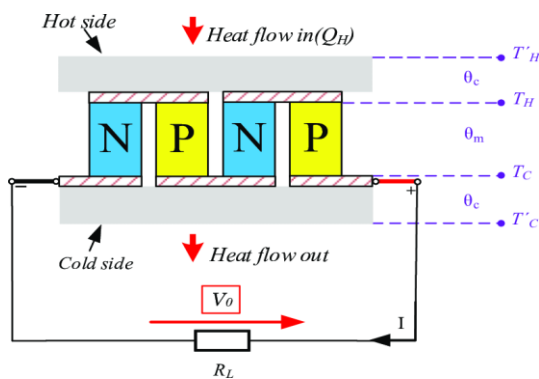
از عناصر پلتیر نیز برای ساخت اتاقک‌های ابری برای تجسم تشعشعات یونیزان استفاده می‌شود. فقط با عبور جریان الکتریکی، آنها می‌توانند بخارات را در دمای زیر ۲۶- درجه سانتیگراد بدون یخ خشک یا قطعات متحرک خنک کنند و ساخت و استفاده از محفظه‌های ابری را آسان می‌کنند.

آشکارسازهای فوتون مانند CCD ها در تلسکوپ‌های نجومی، طیف‌سنج‌ها یا دوربین‌های دیجیتال

می‌شود. ولی در مدل TEG به حالت برعکس کارایی دارد. به این ترتیب با اعمال یک اختلاف دمایی در سطح سرامیکی ماژول، خروجی یک جریان الکتریکی خواهد بود. این مدل در ابعاد مختلف برای مصارف مختلف طراحی می‌شود. المان خنک کننده TEG به دو حالت دما بالا یا High Temperature و حالت دما پایین یا low temperature وجود دارد (۴).



تصویر ۳۲



تصویر ۳۳

## نتیجه گیری

ترموالکترونیک ها فناوری جدیدی هستند که بسیار کاربرد گسترده ای در صنعت و پژوهش پیدا کرده اند و چون ارزان و بدون نویز هستند انتخاب بسیار بهتری نسبت به سایر صفحات فلزی برای انتقال حرارت یا سنسور ها هستند.

بسیار پیشرفته اغلب توسط عناصر پلتیه خنک می شوند. این باعث کاهش تعداد تاریکی به دلیل نویز حرارتی می شود. شمارش تاریک زمانی اتفاق می افتد که یک پیکسل یک الکترون ناشی از نوسانات حرارتی را به جای فوتون ثبت می کند (۱۲). در عکس های دیجیتالی که در نور کم گرفته می شوند، اینها به صورت لکه ها (یا "نویز پیکسل") ظاهر می شوند.

خنک کننده های ترموالکترونیک را می توان برای خنک کردن اجزای کامپیوتر به منظور حفظ دما در محدوده طراحی یا برای حفظ عملکرد پایدار در هنگام اورکلاک استفاده کرد. یک خنک کننده Peltier با یک هیت سینک یا بلوک آب می تواند یک تراشه را تا دمای بسیار پایین تر از محیط خنک کند (۱۳).

در کاربردهای فیبر نوری که طول موج یک لیزر یا یک جزء به شدت به دما وابسته است، از خنک کننده های پلتیر همراه با ترمیستور در یک حلقه بازخورد برای حفظ دمای ثابت و در نتیجه تثبیت طول موج دستگاه استفاده می شود. برخی از تجهیزات الکترونیکی که برای استفاده نظامی در میدان در نظر گرفته شده اند، به صورت حرارتی خنک می شوند.

## TEG

المان خنک کننده TEG مخفف عبارت-Thermo Electric Generator می باشند TEG برعکس TEC کار می کند یعنی اختلاف دمای بین دو سطح را به جریان الکتریکی تبدیل می کند. در مدل های TEC گفته شد که با عبور جریان از داخل ماژول پلتیر، اختلاف دمایی در بین دو سطح سرامیکی ایجاد

1. Versteeg. Peltier Element Identification. 2013
2. Anatyчук LI. Thermoelements and Thermoelectrical Devices. 1979
3. Vayner AL. Thermoelectric Coolers
4. Gromov T. TEC Microsystems GmbH ] 2021
5. Taylor RA. Comprehensive system-thermoelectric level optimization of devices for electronic cooling applications. 2008
6. DiSalvo. Thermoelectric Cooling and Power Generation. 1999
7. Ghoshal. Highly reliable thermoelectric cooling apparatus and method. 2001
8. **Poudel.** High-Thermoelectric Nanostructured Bismuth Performance of Antimony Telluride Bulk Alloys. 2008
9. Ferro. How Winter Woes Inspired A Nanotech Fix For Everything From Cold Necks To Knee Pain. 2013
10. Stokholm LG. Reliability of thermoelectric cooling systems1991
11. for thermal Using Peltier modules management of electronic systems. Electronics Weekly. 2017
12. Gromov G. GLOBAL PHOTONICS APPLICATIONS & TECHNOLOGY Report
13. Fylladitakis. The Phononic HEX 2.0 TEC CPU Cooler Review. 2016